

长沙景嘉微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 业绩电话会议
参与单位名称及人员姓名	长江证券、国泰海通证券、天风证券、西部证券、华创证券、中信证券、山西证券、国联民生证券、兴业证券、百年保险资管、汇添富基金、摩根基金、富国基金、申万菱信、摩根士丹利、银华基金、招商信诺资管、中信保诚基金、中泰自营、金鹰基金、上海孝庸私募基金、健顺投资、创金合信、犁得尔、上海汐泰投资等 42 家机构共 65 位投资者。（排名不分先后）
时间	2025 年 8 月 19 日
地点	上海、电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁 董事会秘书周振武
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司自成立以来致力于信息探测、信息处理和综合应用，为客户提供高品质、高可靠的产品、解决方案和服务。公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。 公司始终专注于产品研发，不断提升产品竞争力。尤其在图形处理芯片设计领域，通过近二十年的技术沉淀，成功研发以

	JM5400、JM7200、JM9 和 JM11 为代表的系列图形处理芯片，应用领域由图形渲染领域拓展至计算领域，并成功实现产业化。 近年来，公司持续在 GPU 研发与应用领域进行布局。未来，公司将继续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本”的核心价值观，“务实高效、持续改进”的工作作风，着力投入研发，不断推进产品迭代，增强公司核心竞争力，为国产图形处理芯片设计技术的提升贡献一己之力。 二、座谈交流环节 1、公司介绍一下 2025 年上半年的总体经营情况？ 2025 年半年度，公司经营业绩有所波动，主要受行业需求影响、部分项目延缓验收，加之公司研发投入加大及市场竞争激烈等多方面因素所致。面对复杂的外部环境，公司围绕战略布局，积极拓展产品应用领域，产品化战略有序推进。 同时，公司聚焦主业发展，坚持技术创新，实施募投项目，2025 年半年度，研发投入 1.53 亿元，占营业收入比重为 79.40%，保证研发投入力度，持续推进产品迭代，积极布局“专用+通用”市场领域；另一方面，公司内部开展管理变革，根据公司中长期战略规划进行技术及产品布局，提升公司管理及研发效率，同时加大业务拓展力度，以应对日益激烈的市场环境。 2、请公司介绍下本次对外投资的情况。 公司、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京智兆陆号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖南财信精睿数字产业股权投资合伙企业（有限合伙）参与了本次无锡诚恒微电子有限公司（以下简称“诚恒微”）增资项目。 公司进军边缘侧 AI 芯片领域，拟使用自有资金 2.20 亿元人民币参与诚恒微增资项目，将直接持有目标公司 33.59%的股权，并通过一致行动关系成为诚恒微的控股股东，诚恒微将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。
--	---

3、请介绍下诚恒微的基本情况。

诚恒微深耕专业集成电路设计，以“普惠智觉技术”为愿景，汇聚了在 AI 芯片领域深耕多年的多个顶尖研发团队，锚定边端侧算力引擎。诚恒微主营业务为边端侧 AI 芯片设计、研发与销售，采用 Fabless 经营模式，业务涵盖了集成电路设计前沿研发、芯片架构设计、配套软件开发及行业解决方案赋能，构建从技术探索到产业落地的全链条能力。

4、公司是如何看待边端侧 AI 芯片的发展前景，诚恒微未来产品应用场景及研发进程情况？

边端侧是指在靠近数据源或终端设备的网络边缘位置，通过集成计算、存储和网络功能，能够就近处理数据，减少对云端中心的依赖。而边端侧 AI 芯片是专门设计用于在边端设备上直接运行人工智能算法的专用芯片，这类芯片通过优化计算架构和算法，在边端侧实现低延迟、高效率的数据处理，实现云边端按需协同。

中国人工智能市场保持高速增长，DeepSeek 等高性能大模型以及模型压缩、轻量化技术的共同出现，不仅降低了 AI 应用的门槛，还将算力逐步下沉到边端侧，持续催生对边端侧 AI 芯片的需求。

目前诚恒微在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧 AI 芯片，该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场，且支持大模型运算，可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、AI 盒子、AI 智能终端等多种场景。边端侧 AI 芯片领域契合人工智能行业发展趋势，具有良好的产业发展前景。目前产品研发正按计划推进。

5、公司本次投资对未来会产生什么影响吗？

	在边端侧 AI 芯片需求爆发式增长的背景下，公司通过本次增资及签署一致行动协议的形式控股诚恒微，充分释放双方在技术、市场与生态层面的协同潜能，构建“高性能 GPU+边端侧 AI 芯片”双轮驱动的新发展格局。 同时能完善公司在 AI 芯片的多元化产品矩阵，不仅能赋能专用领域的智能化体系建设，也能全面覆盖智能终端及通用行业应用场景，创造新的业绩增长点，提升公司应对未来竞争的持续经营能力。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 8 月 19 日